

多層プレス後の外周切断の改革をご提案します。特許出願済
驚きの省エネマシン。多層プリント基板の外周仕上げ加工形状が変わりました。

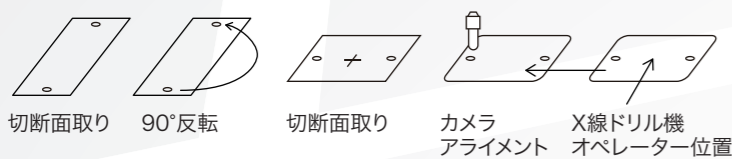
特徴

- 1 ソフミックス独自の切断面取り加工方法でハロゲンフリー材・テフロン材等、材料を選ばない、新切断方式が排出粉塵量を大幅に削減することができます。
- 2 銅箔から厚板まで、スリッターを使わない完全切断が実現、端材トラブルから開放されます。
- 3 2ヶ所の基準穴をCCDカメラで検出し、外周の仕上げ切断をします。
- 4 機械のコンパクト化と軽量構造設計・切断方式の改革で駆動動力源の最小最適化を実現。弊社のHMC旧型機と比較して、実に50%以上の電力削減を可能にしました。実測、約5A以下(AC200V3P)の省エネ運転が実現しました。
- 5 設置スペースを40%(弊社従来機比較)を実現しました。
- 6 当機のパソコンからネットワークする後接続機の一元管理が実現します。
- 7 X線穴明け機と連結で、後工程の完全無人化が実現しました。

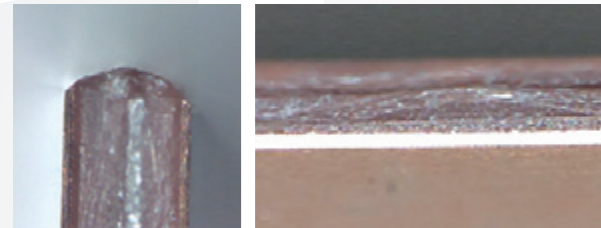
仕上げ加工される形状の比較



加工の流れと状態



加工例



ダクトホースガイド
集塵ホースの破損防止対応

カメラアライメント部



X線穴明け機 多層基板投入位置

NG取出し及び投入パット部

板厚さ
0.16~3.2tが可能

加工速度
650W=1枚/13秒以下
650WF=1枚/10秒以下

切断部



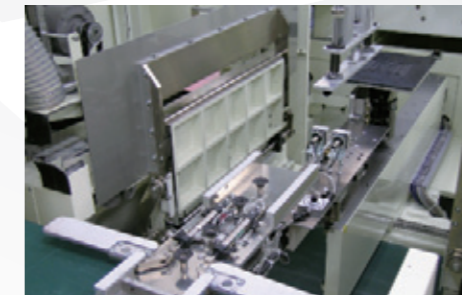
切断仕上げた端材はチャックが確実に取出します。銅箔が切れないトラブルから解放されます。

搬送テーブル部(650WF)



薄板加工時には基板受けが動作して、板垂れを防止します。

薄板対応、搬出パット部(650W)



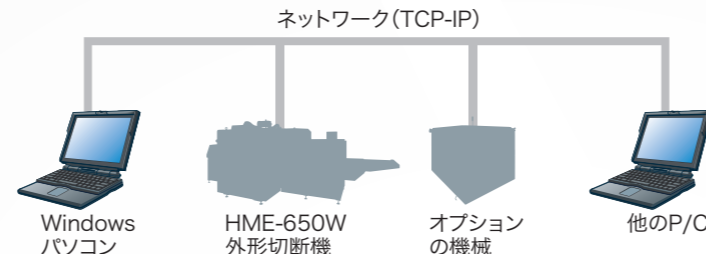
薄板加工時には基板受けが動作して、板垂れを防止します。

カメラアライメント部



カメラ視野は30mm×30mmと拡大しており、視野ズレNGを防止しました。

ネットワーク



データ編集入力

